



平成24年2月28日

各 位

会社名 株 式 会 社 図 研
代表者名 代表取締役社長 金 子 真 人
(コード番号 6947 東証第1部)
問合せ先 財 務 部 長 西 伸 孝
(TEL.045-942-1511)

子会社における債権の取立不能のおそれに関するお知らせ

株式会社図研（代表取締役社長：金子真人、本社：神奈川県横浜市、資本金：10,117百万円）の子会社であります図研エルミック株式会社において、エルピーダメモリ株式会社に対する債権につき、別紙のとおり取立不能または取立遅延のおそれが生じたのでお知らせいたします。

なお、当該事象による平成24年3月期の連結業績への影響は軽微であると見込んでおります。

以 上

平成 24 年 2 月 28 日

各 位

会社名 図研エルミック株式会社
代表者 代表取締役社長 朝倉 尉
(コード番号 4770 東証マザーズ)
問合せ先責任者 管理本部長 江口 慎一
(TEL. 045 - 624-8111)

エルピーダメモリ株式会社に対する債権の取立不能のおそれに関するお知らせ

当社は、平成 24 年 2 月 27 日付けで、エルピーダメモリ株式会社(東京証券取引所第 1 部上場、コード 6665)が、会社更生手続開始の申立てを行ったことに伴い、同社に対する債権について、以下の通り取立不能または取立遅延のおそれが生じたので、お知らせします。

1. 相手方の概要

(1) 商号	エルピーダメモリ株式会社
(2) 本店所在地	東京都中央区八重洲二丁目 2 番 1 号
(3) 代表者の役職氏名	代表取締役社長兼 CEO 坂本幸雄
(4) 事業内容	半導体素子、集積回路等の電子部品の開発、設計、製造、販売および保守など
(5) 資本金	2,361 億円(平成 23 年 9 月 30 日現在)

2. 取立不能または取立遅延のおそれが生じた経緯

エルピーダメモリ株式会社が会社更生手続開始の申立てを行ったため

3. 債権の種類、金額及び純資産に対する割合

(1) 債権の種類	エルピーダメモリ株式会社第 4 回無担保社債 (平成 17 年 12 月 8 日発行、社債間限定同順位特約付)
(2) 金額	額面 100 百万円
(3) 純資産に対する割合	13.4% (直近事業年度末の純資産に対する割合)

4. 今後の見通し

平成 24 年 3 月期の業績への影響につきましては、現在精査中であり、その影響が確定し次第、開示いたします。

以 上